

21

QJ

● **中华人民共和国航天工业部部标准**

QJ 165-89

**航天电子电气产品安装
通用技术条件**

1989-05-10 发布

1989-12-31 实施

中华人民共和国航天工业部 发布

航天电子电气产品安装通用技术条件

1 主题内容与适用范围

1.1 本标准规定了航天电子电气产品安装时的通用要求、设计、工艺、检验要求及质量保证措施。

1.2 本标准是设计、生产、检验和验收的重要依据之一。引用本标准时应在设计文件和工艺文件中注明：“按QJ 165进行安装和验收”。

1.3 本标准也可作为订货方与生产方签订合同的一种技术依据。民用产品可参照本标准执行。

2 引用标准及文件

GB 2423.28 电工电子产品基本环境试验规程 试验 T：锡焊试验方法

GB 2423.32 电工电子产品基本环境试验规程 润湿称量法可焊性试验方法

GB 2681 电工成套装置中的导线颜色

GB 2682 电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色

GB 4728 电气图用图形符号

GB 5094 电气技术中的项目代号

GB 6988 电气制图

GB 7159 电气技术中的文字符号制订通则

QJ 17 线扎图绘制规则

QJ 13 线缆连接图绘制规则

QJ 20 电原理图绘制规则

QJ 21 逻辑图绘制规则

QJ 22 方框图绘制规则

QJ 23 接线图绘制规则

QJ 201 印制电路板技术条件

QJ 603 电缆制作技术条件

QJ 831 航天用多层印制电路板技术条件

QJ 892 航天产品特性分类和管理要求

- QJ 930 绕接技术条件
- QJ 931 电子产品控制多余物规范
- QJ 978 电子产品装配图简化画法
- QJ 1239 电子设备环境试验条件和办法
- QJ 1745 波峰焊接技术条件
- QJ 1721 压接端子和接头
- QJ 1746 压接端子和接头总技术条件
- QJ/Z 76 印制电路板设计规范
- QJ/Z 146 导线端头处理工艺细则
- QJ/Z 147 电子元器件搪锡工艺细则
- QJ/Z 148 漆包线去漆膜工艺细则
- QJ/Z 149 镀膜导线酸洗工艺细则
- QJ/Z 150 导线热压打标记工艺细则
- QJ/Z 151 螺纹连接胶封和点标志漆工艺细则
- QJ/Z 152 圆导体带状电缆安装工艺细则
- QJ/Z 153 MOS 集成电路安装工艺细则
- QJ/Z 154 印制电路板组装件装联工艺细则
- QJ/Z 155 绕接工艺细则
- QJ/Z 156 S01-3 聚氨酯清漆防护喷涂工艺细则
- QJ/Z 157 氮化硼浇注工艺细则
- QJ/Z 158 汽相清洗工艺细则
- QJ/Z 159.1 整机及部件密封灌注工作细则
- QJ/Z 159.2 印制电路板组装件灌封工艺细则
- QJ/Z 159.3 局部封装工艺细则
- QJ/Z 159.4 磁芯板灌封工艺细则
- QJ/Z 160 手工锡焊工艺细则
- QJ 1722 线扎制作工艺细则
- QJ 1781.4 P.P.S. 聚氨酯有机硅改性绝缘漆防护喷涂工艺细则
- QJ 1781.1 S31-11 聚氨酯绝缘漆防护喷涂工艺细则
- QJ 1781.3 7182 聚氨酯清漆防护喷涂工艺细则
- QJ 1781.2 7385 聚氨酯清漆防护喷涂工艺细则

条例:

《军工产品质量管理条例》 中央军委颁发

《航天工业部型号产品质量保证措施》 航天工业部颁发

3 一般要求